



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座



端子制造: 实芯

位数: 8

连接器外形: 零

行间距: 7.62 mm [.3 in]

端子接触部电镀材料: 锡铅

## 产品特性

### 结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	8

### 电气特征

绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	10 mΩ

### 主体特性

框架种类	薄膜支架
连接器外形	零

### 接触件特性

接合接触类型	四指
IC 插座类型	DIP
端子类型	插座
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	锡铅
	25 μin
端子额定电流 (最大值)	3 A

### 端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm [.125 in]
-----------	-------------------

PCB 端接方法

通孔 - 焊接

### 壳体特性

中心线 (间距)

2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

PCB 的外形高度

0 mm[0 in]

行间距

7.62 mm[.3 in]

### 使用环境

工组温度范围

-55 – 105 °C

### 包装特性

封装数量

5000

封装方法

Reel

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

未进行合规性审核

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月 (144)  
超过限值的SVHC：  
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

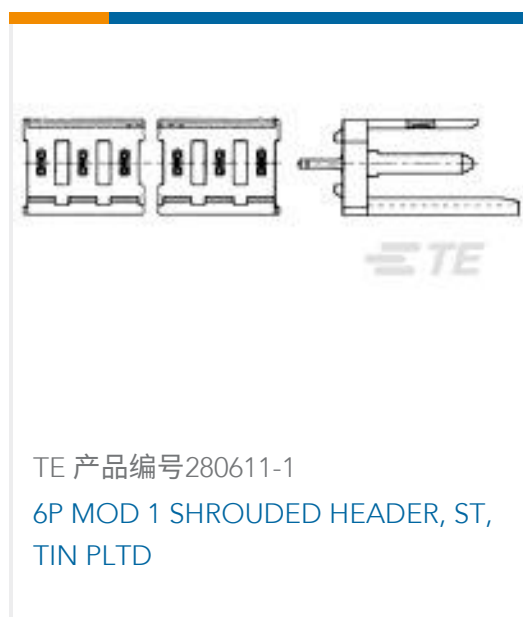
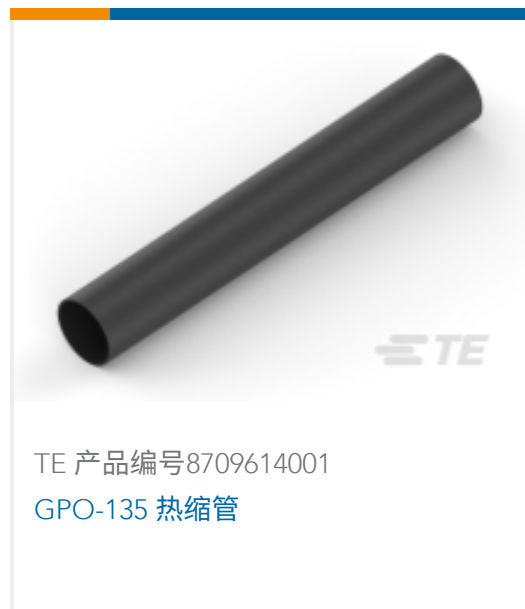
焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 客户还购买了



## 文档

[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)